

発泡ポリウレタンパッド

IC1000™

高い性能を求められる半導体デバイスのCMP工程において、性能、安定性、信頼性の全てにおいてバランスのとれた研磨パッドがIC1000™です。

これまでに数多くの採用実績があり、今もなお高いシェアを維持しています。

IC1000™は、特殊な材料・製造・加工技術、そして高いアプリケーション・評価技術をベースにデザインされていますので、最適なパフォーマンスをお届けします。

IC1000™ シリーズ

CMPプロセスにおける研磨用パッドのデファクトスタンダード、それがIC1000™です。特殊ポリウレタン材料をベースに、均一な微小発泡を持つそのユニークな構造はスラリーの保持性を向上させ、さらにパッド表面溝加工を施すことにより、スラリーをウェーハ全面へ均一に行き渡らせ、高い研磨性能を実現します。

□ 物 性

	規格 (※)
厚み (mm)	1.17 - 1.37
圧縮率 (%)	0.5 - 4.0
硬度 (Shore-D)	52 - 62
密度 (g/cm ³)	0.77 - 0.83

(※) 50mil Type A6の場合

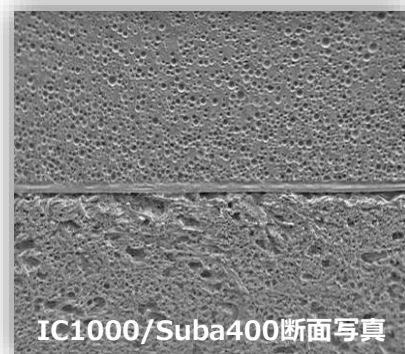


□ 溝加工

- ・ パーフォレーション
- ・ XY溝
- ・ 同心円溝
- ・ 放射溝
- ・ 上記複合溝

□ 積層パッド

- ・ 下層パッドSuba™シリーズとの組み合わせにより、優れた加工均一性を達成します。



IC1000/Suba400断面写真

※ IC1000™は、ニッタ・デュポン(株)またはDuPont de Nemours, Inc.もしくはその関連会社の商標です。Suba™は、DuPont de Nemours, Inc.もしくはその関連会社の商標です。

※ 記載されている物性値等の数値は代表値を示しており、製品の規格を保証するものではありません。